

证券代码：603186

证券简称：华正新材



WAZAM
华正新材

浙江华正新材料股份有限公司
2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资
金使用的可行性分析报告

二〇二六年三月

一、本次募集资金使用计划

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 120,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金投资金额
1	年产 1200 万张高等级覆铜板项目	100,401.00	100,000.00
2	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		120,401.00	120,000.00

其中，“年产 1200 万张高等级覆铜板项目”项目的实施主体为公司全资子公司珠海华正新材料有限公司。本次发行的募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度、资金需求轻重缓急等情况，自筹资金支付上述项目所需的资金；本次募集资金到位后，公司将以募集资金进行置换。若本次发行实际募集资金数额低于项目的募集资金拟投资额，则不足部分由公司通过自筹方式解决。

二、本次募集资金投资项目可行性分析

（一）年产 1200 万张高等级覆铜板项目

1、项目概况

“年产 1200 万张高等级覆铜板项目”预计总投资 100,401.00 万元，拟使用募集资金投资 100,000.00 万元，本项目重点布局高速覆铜板、高频覆铜板、高导热金属基板、HDI 覆铜板等高端产品线。上述产品主要应用于 AI 服务器、交换机、光模块、5G 通信基站、汽车毫米波雷达及消费电子产品等领域，满足下游客户持续增长的需求。项目建成达产后，将新增年产 1200 万张高端覆铜板产能，有效扩充公司在高频高速等高端覆铜板领域的生产能力。

覆铜板（Copper Clad Laminate，简称 CCL）系用于印制电路板（简称 PCB）制造的核心材料之一，是将玻璃纤维布或其它增强材料浸以树脂，一面或双面覆以铜箔或其他金属层并经热压而制成的一种板状材料，担负着 PCB 导电、绝缘、支撑三大功能，对 PCB 产品中的传输速度、能量损失和特性阻抗等起到决定性作用。覆铜板直接应用于 PCB 生产制造中，最终与电子元器件等进行表面贴装后，被广泛应用于计算机、手机、通讯、航空航天、汽车等众多领域。随着 AI

算力基础设施加速扩容、通信技术代际升级及汽车电子化程度提升，下游市场对具备低介电损耗、高耐热性及高稳定性的高频高速覆铜板需求持续增长，推动行业进入技术迭代与产能扩张并行的发展阶段。

公司已在杭州、珠海两地建成了三个生产基地，实现了覆铜板制造能力的迭代升级与华东、华南区域产能的战略布局。本次“年产 1200 万张高等级覆铜板项目”的实施，旨在顺应高频高速覆铜板市场扩容趋势，依托公司现有技术沉淀与客户基础，新建符合高端产品生产工艺要求的专用产线，进一步扩大高端产能规模、优化产品结构。项目建成后将增强公司对华南地区下游客户的配套服务能力和高端覆铜板产品的供应能力，巩固并提升公司在覆铜板行业的市场地位，为公司在高端材料领域的持续发展夯实基础。

2、项目实施的必要性

（1）顺应 AI 算力时代需求，把握行业战略机遇

当前覆铜板行业正处于技术升级与需求扩容并行的关键阶段。AI 服务器、高速交换机及光模块等算力基础设施的迭代演进，对覆铜板在高频高速环境下的介电损耗、耐热性及稳定性提出了更高要求，推动行业产品结构向高端化转型。这与国家产业政策导向高度契合，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》已将集成电路与人工智能、量子信息等一同列为“十四五”时期需要“强化国家战略科技力量”的重要领域，《“十四五”信息通信行业发展规划》《“十四五”数字经济发展规划》《“十四五”国家信息化规划》等系列配套政策持续落地，为电子信息产业及上游核心材料产业构筑了良好的政策环境。与此同时，2025 年 10 月发布的“十五五”规划进一步明确，完善新型举国体制，采取超常规措施，全链条推动推动集成电路、先进材料等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。

随着全球 PCB 高多层产能往国内转移，FR-4 等常规覆铜板的国内市场份额中，建滔积层板、金安国纪、生益科技、南亚新材和华正新材等国产供应商的占比逐年提升。但高端覆铜板，如三大类特殊刚性覆铜板（高速、高频及 IC 封装材料等特殊覆铜板）市场仍由中国台湾、日本、韩国厂商主导。根据 Prisma 数据，2024 年全球三大类特殊刚性覆铜板前五大厂商合计市场份额为 62.60%，

前十五大企业中，中国大陆企业生益科技、南亚新材和华正新材市场份额合计仅为 8.30%，高端产品进口依赖度较高，国产替代空间广阔。这一现状与公司“十五五”期间高端覆铜板产品的研发与产业化目标高度契合，Fan-out、2.5D/3D、Chiplet 等先进封装技术的快速迭代，更为公司创造了重要的市场机遇。

公司作为国内覆铜板行业领军企业之一，长期聚焦高频高速、高导热及半导体封装材料等高端领域。本次发行募集资金用于“年产 1200 万张高等级覆铜板项目”建设，旨在把握行业发展机遇，加速高端产品产能布局，符合公司聚焦主业深化发展、构建技术领先的科技型新材料平台企业的战略布局。

(2) 扩展产能规模，优化产品结构，提升公司市场竞争力

经过二十余年的深耕细作，公司持续加大研发投入，在高速覆铜板领域已形成涵盖 Very Low-loss 至 Extreme Low-loss 等级的全系列产品布局，通过优化树脂体系与铜箔表面处理工艺，实现信号传输速率与可靠性的双重突破，产品性能指标逐步接近国际先进水平，并已在部分终端客户实现批量应用；在高频覆铜板领域，公司无线通信市场份额稳步提升，核心应用场景地位稳固，高导热高频覆铜板实现技术突破，可应用于毫米波天线、毫米波雷达等的产品已实现稳定生产和供应。依托杭州青山湖生产基地及珠海高性能覆铜板一期、二期项目相继建成投产所积累的高端产品规模化供给经验，公司技术储备与产业化能力得到持续验证。

然而，高端覆铜板对生产环境洁净度、工艺控制精密度及设备稳定性具有更高要求，公司现有产线难以充分满足高等级产品的大规模量产需要。产能瓶颈已成为制约公司承接高端订单、扩大市场份额的关键因素。为应对日益激烈的行业竞争，突破高端覆铜板核心技术瓶颈，缩小与海外企业的技术代差，本次发行募集资金将用于建设符合高端覆铜板生产工艺要求的专用产线，实现高端产能的规模化扩充，有助于提升公司对下游客户的服务能力，进一步巩固公司在国内覆铜板行业中的市场地位，提升国际市场竞争力。

3、项目实施的可行性

(1) 国家产业政策密集加持，为项目实施提供良好的政策环境

电子信息制造业是国民经济的战略性、基础性和先导性产业，覆铜板作为电

子工业的基础材料，受到国家政策的大力支持。继《“十四五”信息通信行业发展规划》《“十四五”数字经济发展规划》《“十四五”国家信息化规划》等系列配套政策落地后，《电子信息制造业 2025-2026 年稳增长行动方案》明确提出要提升产业链供应链韧性和安全水平，《产业结构调整指导目录（2024 年本）》将高性能覆铜板等电子产品用材料列入鼓励类方向。上述政策为覆铜板等核心电子材料产业的技术创新、成果保护与高质量发展提供了多重保障，本项目聚焦高速高频覆铜板的研发与产业化，符合国家战略需求与产业政策导向，具备充分的政策实施可行性。各项政策的协同落地，为项目的顺利实施与长期运营、产业链布局深化构筑了良好的政策环境与宏观支撑。

（2）公司研发体系完善，为项目实施提供技术支撑

公司高度重视研发投入，已建立完善的研究体系，打造产学研相结合的研发能力。公司自 2003 年成立以来，始终以覆铜板为核心主业，深耕产品技术研发与制造工艺迭代优化，逐步搭建起标准化、精细化的生产管理体系，为企业长远发展积淀了扎实的技术储备与良好的行业信誉。依托于国家企业技术中心、CNAS 认证检测中心等优质研发平台，在高端覆铜板领域，公司已构建起成熟产品线（H1）、成长产品线（H2）、种子产品线（H3）多层次产品矩阵，产品广泛服务于 AI 服务器主板、光模块、5G 通信基站、汽车电子控制系统等高端应用场景，成功跻身国内覆铜板行业前列，形成产品系列齐全、客户结构稳健的核心竞争优势。核心技术团队具备丰富的高端覆铜板研发与产业化经验。截至 2025 年末，公司牵头、参与国家及行业标准化工作，共参与 35 项标准的制定，其中国际标准 3 项、国家标准 16 项、行业标准 5 项、团体标准 11 项。完善的研发体系与成熟的技术储备，能够保障本项目产品的技术先进性、量产稳定性与持续迭代能力，为项目实施提供核心技术支撑。

（3）优质的客户资源及产品，为项目新增产能消化提供市场保障

公司凭借深厚的技术储备和丰富的产品类型，积累了稳定的客户资源，为项目新增产能的消化提供了充分的市场可行性。公司产品已实现多领域广泛应用，覆盖 5G 通信、服务器与数据中心、半导体封装、新能源汽车、智慧家电、医疗设备、轨道交通及绿色物流等核心赛道。公司以终端客户认证带动销售，在后续

的客户开拓、产品营销等方面走在了市场前沿。公司深耕覆铜板行业二十余年，已与 PCB 行业前 100 强企业中的大部分客户建立了长期稳定的业务合作关系，形成了覆盖通信、AI 服务器、汽车电子、消费电子等多领域的客户矩阵。高速覆铜板方面，有卤 Ultra Low-loss 等级材料已实现批量销售，无卤 Ultra Low-loss 等级材料在性能上表现优异，并已获得国际知名芯片终端的认可，Ultra Low-loss (Low CTE) 材料已通过国内头部终端认证，并实现小批量订单，应用于大芯片智算领域，领先于国内外其他同行的产品；Extreme Low-loss 等级国产化产品已参与国际知名芯片终端的测试认证，测试顺利，并持续推进中国台湾与欧美终端客户认证；高频覆铜板方面，公司不断提升和巩固已有市场份额，在现有产品基础上加快对低损耗、高导热、低 CTE 高频材料的研发速度，并加大新产品市场拓展力度。公司将持续巩固深化与现有客户的合作关系，积极开拓新客户，为新增产能的消化提供有力保障。

4、项目实施主体与投资概算

本项目实施主体为珠海华正新材料有限公司，系上市公司的全资子公司。项目实施地点位于广东省珠海市。本项目总投资 100,401.00 万元，拟使用募集资金 100,000.00 万元。

5、项目的经济效益评价

本项目顺利实施后，预计具有良好的经济效益。

6、项目涉及的政府报批情况

截至本报告公告日，本项目的备案、环评手续尚在办理中，公司将根据相关要求履行审批程序。

(二) 补充流动资金

1、项目概况

公司本次募集资金拟使用 20,000.00 万元用于补充流动资金，以满足未来业务增长的营运资金需求，优化公司资本结构，推动公司进一步发展。

2、补充流动资金的必要性

(1) 满足业务持续发展的资金需求

覆铜板行业属于技术密集与资本密集型产业，产线建设、技术研发及市场拓展均需持续的资金投入。近年来，公司正处于产品结构优化与产能布局调整的关键时期，对营运资金的需求亦随之增长。通过本次股权融资募集资金，可以及时补充公司营运资金，满足业务持续发展的资金需求。

（2）降低公司资产负债率、优化资本结构

2023年12月31日、2024年12月31日和2025年12月31日，公司合并口径资产负债率分别为72.96%、75.51%和72.36%，与同行业公司相比，处于较高水平，具体对比如下：

同行业可比公司	合并口径资产负债率		
	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
生益科技	尚未披露	40.29%	37.09%
金安国纪	尚未披露	45.05%	42.25%
南亚新材	尚未披露	46.86%	45.55%
平均值	-	44.07%	41.63%
华正新材	72.36%	75.51%	72.96%

资料来源：Wind 资讯。

注：截至本报告披露日，同行业可比公司 2025 年年度报告尚未披露。

本次募集资金总额到位后，公司资产负债率将大幅下降，将有效优化公司资本结构，提升营运能力和风险抵御能力，为公司实现高质量可持续发展提供坚实的资金保障。

三、本次募集资金运用对公司的整体影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

本次募投项目围绕公司主营业务展开，符合国家相关产业政策和公司的整体战略规划，具有良好的市场前景。项目建成后，公司将依托产能扩充与技术能力提升，进一步优化产品供应体系，深化在 AI 服务器、高速通信等下游应用领域的业务布局。通过规模化生产与工艺迭代，公司可更好地满足市场对高频高速覆铜板的增量需求，提升主营业务市场份额与综合竞争力。项目的实施符合公司长期发展战略，有利于增强持续经营能力，维护全体股东的长远利益。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司资金实力将进一步增强，总资产和净资产规模相应提升，财务结构更趋合理，整体抗风险能力有效增强。由于募投项目从建设到实现预期效益需经历产能爬坡和市场培育过程，短期内随着股本规模扩大，每股收益等指标可能出现阶段性摊薄。但募集资金到位后，随着公司发展战略的推进及本次募投项目的实施，公司的市场布局将进一步完善。长期来看，公司战略的实施将增强公司的综合竞争实力和抗风险能力，有利于各盈利指标的优化，公司整体盈利能力将随之进一步提高。

四、募集资金投资项目可行性结论

综上所述，本次募集资金投资项目围绕公司现有主营业务进行，项目符合国家相关产业政策及公司战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。项目建成后，能够进一步提升公司的资产质量和盈利水平，增强公司核心竞争力和抗风险能力，促进公司持续健康发展。因此，本次募集资金投资项目建设具备可行性，符合公司及全体股东利益。

浙江华正新材料股份有限公司董事会

2026年3月20日